

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-27

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 现场参观 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 其他（_____）
活动参与人员（排名不分先后）	国泰海通、华创证券、华泰证券、嘉实基金、泉果基金、上海证券、施罗德基金、易方达基金、永赢基金、招商证券、中国国际金融、银华基金、诺德基金、安信基金、长城基金、华夏基金、恒越基金、创金合信基金、博时基金、九泰基金、国金基金、汇添富基金、泰信基金、天弘基金、金元顺安基金、安联基金、国融基金、国投瑞银基金、浦银安盛基金、长盛基金、申万菱信基金、农银汇理基金、诺安基金、财通基金、方正富邦基金、摩根士丹利基金、摩根证券投资信托、路博迈（亚洲）、广东君心盈泰投资、上海保银私募基金、上海聆泽投资、淡水泉(北京)投资、耕霖(上海)投资、北京市星石投资、北京泽铭投资、江苏瑞华投资、上海雷钧私募基金、湖南源乘私募基金、上海明河投资、相聚资本、上海姚泾河私募基金、诚朴（深圳）资产管理、海南恒立私募基金、北京博星隆创意股权投资、上海世亨私募基金、盛钧私募基金管理(湖北)、中金资本、中信建投证券、国海证券、平安证券、国元证券、太平洋、中银国际证券、中航证券、中原证券、西南证券、西部证券、国信证券、华源证券、兴业证券、中国银河、中信证券、野村国际(香港)、第一上海证券、民生证券、太平洋证券、中泰证券、瑞银证券、财通证券、浙商证券、汇丰前海、建银国际证券、华福证券、上海国泰君安证券资产管理、前海再保险、路博迈基金、昆仑健康保险、陆家嘴国泰人寿保险、长江养老保险、东亚前海证券、高盛（中国）证券、圆方资本、招银国际环球、Grand Alliance Asset Management、花旗环球金融亚洲有限公司、富达基金管理(中国)、东吴基金、开源证券、宏利基金、国泰君安国际、摩根士丹利证券、上海复星高科技（集团）、人保资产、大家资产管理、太平资产、生命保险资产管理、深圳市辰禾投资、复星财富国际控股
上市公司接待人员	副总经理、董事会秘书：张丽君；战略发展部总监、证券事务代表：谢丹；

时间	2025 年 8 月 27 日
地点	网络及电话会议、公司会议室
形式	网络及电话会议、实地调研
投资者关系 活动主要内容介绍	交流主要内容： Q1、请介绍公司 2025 年半年度经营业绩情况。 2025 年上半年，在人工智能技术革新的驱动下，电子电路行业持续显现出结构性增长机会。报告期内，公司实现营业总收入 104.53 亿元，同比增长 29.21%，归母净利润 13.60 亿元，同比增长 37.75%。上述变动主要得益于公司把握 AI 算力升级、存储市场回暖和汽车电动智能化增长机遇，实现了三项主营业务收入的同比增长。与此同时，得益于 AI 加速卡、服务器及相关配套产品等需求持续提升，400G 及以上的高速交换机、光模块需求显著增长，产品结构持续优化，助益利润同比提升。 Q2、请介绍 2025 年上半年公司 PCB 业务营业收入及毛利率的变动原因。 PCB 产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。 2025 年上半年，PCB 业务实现主营业务收入 62.74 亿元，同比增长 29.21%；业务毛利率 34.42%，同比增加 3.05 个百分点。PCB 业务把握算力以及汽车电子市场的机遇，实现营收和利润的稳健增长。营收层面的增长贡献主要为 AI 加速卡等产品需求释放，数据中心领域占比进一步提升；400G 及以上的高速交换机、光模块需求显著提升，有线侧占比增加；以及汽车电子和 ADAS 的增长。毛利率在营收规模增加、产能利用率相对高位、产品结构优化的情况下亦有所提升。 Q3、请介绍 2025 年上半年公司封装基板业务营业收入及毛利率的变动原因。 公司封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。 2025 年上半年，封装基板业务实现主营业务收入 17.40 亿元，同比增长 9.03%，业务毛利率 15.15%，同比减少 10.31 个百分点。公司封装基板业务牢牢把握国内存储市场增长的机遇，加大市场拓展力度，推动订单较去年同期显著增长。封装基板业务毛利率同比下降，主

要由于广州封装基板项目处于产能爬坡阶段，金盐等部分原材料涨价，使得成本及费用较同期增加。

Q4、请介绍广州封装基板项目连线爬坡进展。

公司广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力持续提升，已具备 20 层及以下产品批量生产能力，22~26 层产品的技术研发及打样工作按期推进中；产能爬坡稳步推进，已承接 BT 类及部分 FC-BGA 产品的批量订单。2025 年上半年广州广芯亏损环比有所收窄。

Q5、请介绍公司泰国项目规划及当前建设进展。

公司在泰国工厂总投资额为 12.74 亿元人民币/等值外币，目前已连线试生产。泰国工厂将具备高多层、HDI 等 PCB 工艺技术能力，其建设有利于公司进一步开拓海外市场，满足国际客户需求，完善产品在全球市场的供应能力。

Q6、请介绍公司上半年工厂产能利用率情况。

公司综合产能利用率仍处于相对高位。2025 年上半年，基于 AI 算力及汽车电子市场的需求，PCB 业务总体产能利用率处于相对高位；封装基板业务因存储领域需求的增长，工厂产能利用率环比明显提升。

Q7、请介绍原材料价格变化情况及对公司的影响。

公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多。2025 年上半年，受大宗商品价格变化影响，金盐等部分原材料价格同比提升、环比亦有一定涨幅。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。

Q8、请介绍公司 2025 年上半年研发投入情况。

2025 年上半年公司研发投入金额约 6.72 亿元，占公司营收比重为 6.43%。公司各项研发项目进展顺利，下一代通信、数据中心及汽车电子相关 PCB 技术研发，FC-BGA 基板产品能力建设，FC-CSP 精细线路基板和射频基板技术能力提升等项目均按期稳步推进。

	Q9、PCB 新产能建设情况。 公司 PCB 业务在深圳、无锡、南通及泰国项目（在建）均设有工厂。PCB 新增产能主要来自新建工厂和原有工厂技术改造，其中新建工厂包括南通四期和泰国工厂，南通四期预计今年四季度连线，泰国工厂目前已连线；同时，公司也通过对现有成熟 PCB 工厂进行技术改造和升级，打开瓶颈，提升产能。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无